

# 各社 熱伝導ラバーシート比較表 2018/01/15

JBS	特性	パークイスト	フジポリ	信越シリコン	用途
TCP-110U	高熱伝導パッド 熱伝導性:1.1w/mk ガラス繊維強化片面非粘着性 他面粘着性	ギャップパッド VO Soft ギャップパッド VO Ultra-Soft ギャップパッド 1500R	NA	NA	ICとヒートシンク間 BGA's,QFP,SMT パワー半導体 トランス、コイル など、ヒートパイプ冷却,メモリーモジュールや ハードディスクユニット冷却,電源、IGBT modules,シグナルアンブ(発熱素子とシャーシ間)
TCP-I160F	高熱伝導絶縁シート 熱伝導性:1.6w/mk ガラス繊維強化 両面非粘着性	Sil pad 900s Sil pad 800 Sil pad 400	GTR,GHR	TC-CG series,TC-FG series	発熱素子とヒートシンク間 またはレールの間に挿入 民生電子機器、自動車システム、通信、航空、産業用
TO-220A	熱伝導性キャップ 熱伝導性:1.6w/mk ガラス繊維強化 両面非粘着性	Sil pad Tube 400	TR,HR,QR	TC-A-CP	チップ実装型 パワー半導
TCP-K10	高熱伝導絶縁シート 熱伝導性:1.3w/mk ポリイミド強化 両面非粘着性	Sil-pad K-10 Sil-pad K-6 Sil-pad K-4	NA	TC-15TCI,TC-11KI	パワー半導体、モータ制御、電源
TCP-150	高熱伝導パッド 熱伝導性:1.5w/mk 両面自然粘着性	ギャップパッド 1500 ギャップパッド 1450	GR-ae,GR-d,GR-Sd,GR14A	TC-100HSV-1.4	LED照明 applications,コンピュータ並びに周辺機器、通信機器等日発熱素子とヒートシンク間に挿入
TCP-250	高熱伝導パッド 熱伝導性:2.5w/mk 両面自然粘着性	ギャップパッド 2500	GR25A	TC-100HSV-1.4	LED照明 applications,コンピュータ並びに周辺機器、通信機器等日発熱素子とヒートシンク間に挿入
TCP-300SF	非シリコーン 高熱伝導パッド 熱伝導性:3.0w/mk 両面自然粘着性	ギャップパッド 2200SF	NR-c,PG25A	NA	モータ、リレー、スイッチなど
TCP-500	高熱伝導パッド 熱伝導性:5.0w/mk 自然粘着性	ギャップパッド 5000	GR45A,GR-Pm	TC-100TXS,TC-100TXS2,TC-100TXE,TC-100CAT-20	レギュレータ、メモリモジュール、BGA's,基板とシャーシ間,ASIC and DSPs
TCP-800	高熱伝導パッド 熱伝導性:8.0w/mk 両面自然粘着性	NA	GR80A,PG80A	NA	コンピュータ並びに周辺機器、通信機器等日発熱素子とヒートシンク間に挿入
TCP-1200	高熱伝導パッド 熱伝導性:12.0w/mk 両面自然粘着性	NA	XR-m	NA	コンピュータ並びに周辺機器、通信機器等日発熱素子とヒートシンク間に挿入
TCP-300G	熱伝導性グリース 熱伝導性:3.0w/mk	ギャップフィラー 2000 ギャップフィラー 3500S35	SPG-20A,SPG-20B,SPG-30B	G-775,G-777,G-765,G-750,	コンピュータ並びに周辺機器、通信機器等日発熱素子とヒートシンク間に挿入,自動車用パワーデバイス,
TCP-500G	熱伝導性グリース 熱伝導性:5.0w/mk	ギャップフィラー 4000	SPG-50A	G-751,X-23-7921-5,	コンピュータ並びに周辺機器、通信機器等日発熱素子とヒートシンク間に挿入,自動車用パワーデバイス,
TCP-150AE	EMIノイズ吸収用 高熱伝導パッド 熱伝導性:1.5w/mk	NA	EGR-11F	NA	コンピュータ並びに周辺機器、通信機器等日発熱素子とヒートシンク間に挿入,自動車用パワーデバイス,